证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2026-025

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月14日（星期四）14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年05月06日（星期三）至05月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investors@southchip.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月14日下午14:00-15:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月14日（星期四）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：院晨杰先生

董事会秘书：梁映珍女士

财务负责人：赵寨先生

独立董事：林洋女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月14日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月06日（星期三）至05月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investors@southchip.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：梁映珍

电话：021-50182236

邮箱：investors@southchip.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2026-021

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对上海南芯半导体科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案［(2021)京74民初111号］作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次，监督管理措施12次、自律监管措施13次，纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、项目签字注册会计师：廖传宝先生，2007年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为南芯科技提供审计服务，近三年签署过江淮汽车（600418）、科威尔（688551）、埃科光电（688610）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王凤艳女士，2014年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为南芯科技提供审计服务，近三年签署过南芯科技（688484）、浙江交科（002061）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张玉卿女士，2026年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为南芯科技提供审计服务，近三年参与过浙江建投（002761）、浙江交科（002061）等上市公司审计。

项目质量复核人：施琪璋先生，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过广信股份（603599）、洽洽食品（002557）、巨一科技（688162）、鑫铂股份（003038）等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人廖传宝、签字注册会计师王凤艳、签字注册会计师张玉卿、项目质量复核人施琪璋近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2025年度的年报审计费用为人民币65万元，内控审计费用为18万元。2026年度审计费用根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，2026年度的年报审计费用为65万元，内控审计费用为18万元，与2025年度审计费用持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2026年4月28日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况等情况进行了审查，认为其具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2026年度审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议的审议意见

公司于2026年4月28日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议，经与会全体独立董事审议表决，一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事认为：2025年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，其在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。为保持公司2026年度审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开的第二届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意提交股东会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

公司代码：688484 公司简称：南芯科技

上海南芯半导体科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的相关内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年4月28日公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司拟以权益分派实施股权登记日的公司总股本427,663,170股扣除公司回购专户现持有的股份1,752,889股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利106,477,570.25元，公司2025年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在分配方案实施权益分派的股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。本议案尚需提交股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	南芯科技	688484	无

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁映珍	王蓉
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路565弄54号（4幢）1201	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路565弄54号（4幢）1201
电话	021-50182236	021-50182236
传真	021-58309622	021-58309622
电子信箱	investors@southchip.com	investors@southchip.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是国内领先的平台型模拟与嵌入式芯片设计企业，主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售。公司产品覆盖消费电子、汽车电子、工业应用领域等核心赛道，并深度布局云网边端AI全场景。凭借平台化技术积累与全产业链布局能力，公司已构建起“全领域覆盖、多技术协同、跨场景赋能”的业务生态，持续为全球客户提供高性能、高品质与高经济效益的系统解决方案。

（1）消费电子

在消费电子领域，公司已发展成为覆盖多元化终端、提供多样化芯片方案、服务全球知名品牌客户的领先芯片设计公司。凭借在手机、笔记本电脑/平板电脑、可穿戴设备、AI智能眼镜、智能音箱、AR/VR设备等从核心到新兴的全场景产品渗透，公司不仅稳固了在智能手机等传统优势市场的领导地位，更以前瞻性的产品布局，全面赋能由AI驱动的下一代智能硬件生态，构筑了坚实且持续成长的业务基本盘。

公司在消费电子市场的优势地位体现在能提供高效率、高集成度与高可靠性的完整解决方案，产品广泛涵盖有线/无线充电管理、显示屏电源管理、锂电保护及电量计量等关键领域，通过芯片间的有效匹配与协同，确保了终端设备电源系统的最佳性能、安全与成本优势，从而赢得了客户的广泛认可与持续合作。公司产品已规模量产应用于小米、OPPO、vivo、荣耀、三星等全球主流品牌，尤其在旗舰及畅销机型中已成为核心电源管理方案的主要供应商，出货量与销售额均居行业领导地位，并多次获得客户颁发的“技术创新奖”“最佳供应商”等重要奖项。

（2）汽车电子

汽车电子是公司战略投入的重点方向，公司从车载充电切入，通过近年来持续加大资源投入，已逐步拓展至智能座舱、智能驾驶、车身控制等全场景，构建起覆盖“感知、传输、决策、执行”的完整车载芯片生态。

在车载充电领域，公司打造了涵盖不同功率等级、支持多种公私有协议的全面产品组合，推出多款高功率、高协议兼容性的车载充电芯片，成功切入汽车头部厂商供应链。

在智能座舱领域，公司产品包括升/降压的DC-DC芯片、线性电源LDO、智能负载开关等产品，满足座舱电子设备的高效供电需求。

在智能驾驶领域，公司展现出强劲的先发优势与技术实力：率先发布单芯片车载摄像头PMIC系列产品，快速构建起覆盖环视、周视、车内摄像头及毫米波雷达的完整产品矩阵，包括非功能安全SC6201Q系列、ASIL B级SC6205Q/SC6206Q系列、专为车内摄像头设计的SC6208Q系列，以及ASIL B级毫米波雷达PMIC SC6207Q、ASIL D级（汽车功能安全最高等级）SC6258XQ/SC6259XQ系列等。这些产品集成度高、兼容性强，可精准满足不同客户的差异化需求，为智能驾驶融合感知系统提供稳定可靠的电源支持。

在车身控制领域，公司产品覆盖高低边驱动控制芯片、eFuse、马达驱动芯片、带功能安全的电源管理芯片、CAN/LIN接口芯片等，全面适配汽车车身电子的严苛要求。公司已通过ISO26262功能安全管理体系认证，产品从ASIL B到ASIL D的功能安全等级全覆盖，凭借全国产化产业链优势、快速定制响应能力及高可靠性，获得安波福等Tier1供应商及主机厂的认可，加速推动汽车芯片国产替代。

（3）工业应用领域

公司在工业领域的布局持续深化，围绕工业电源、储能、光伏、通信等核心场景，推出多款针对性产品，同时布局传感与控制芯片，进一步拓宽工业应用边界，自研工艺平台，突破环境干扰控制、算法可靠性等技术难点，将业务拓展至工业机器人、智能传感终端等更高精度要求的工业场景，构建“电源管理+传感控制”的工业业务布局。

综上，南芯科技已构建起覆盖消费电子、汽车电子、工业应用的全场景业务布局，凭借平台化的技术研发能力、全产业链的产品适配能力及快速响应的客户服务能力，实现了多领域协同发展、新兴赛道重点突破的业务格局。未来，公司将持续深化技术积累，扩大研发投入，巩固消费电子领域优势，加速汽车电子、工业应用的市场渗透，抢占AI、机器人等新兴领域发展机遇，持续提升全球市场竞争力与盈利能力。

2.主要产品

公司现有产品已覆盖消费电子芯片（含电池管理芯片、电源管理芯片）、汽车电子芯片、工业领域芯片和智能算力领域电源管理芯片，通过打造丰富的产品矩阵，满足客户系统应用需求，是国内领先的模拟和嵌入式的芯片设计厂商。

（1）消费电子芯片

公司主要为消费电子各类移动设备终端提供稳定、安全的电池和电源管理解决方案。公司消费电子产品为客户应用提供多种功能的芯片，包括充电管理芯片、锂电保护芯片、电量计量芯片、显示电源管理芯片、交直流转换芯片等，可满足不同移动设备的电池管理、电源管理等核心需求。

产品类别	产品介绍
电池管理芯片	公司电池管理芯片涵盖有线、无线、通用充电及锂电管理等系列，有线充电芯片采用多拓扑架构，支持10W至300W功率及多串电池充放电管理；无线充电芯片基于电磁感应实现无接触能量传输，提供发射、接收及一体方案。通用充电芯片实现恒流恒压充电与全场景保护，锂电管理芯片则精准监测电芯状态，进行电量计量与多重安全防护，全面提升电池安全性与使用寿命。
电源管理芯片	公司电源管理芯片产品齐全，覆盖多场景应用，涵盖设备类端到端的全链路解决方案。交流电到直流电控制芯片提供电能调制和转换，同时具备通讯、存储、反充控制等功能，实现智能充电管控。显示电源管理芯片为屏幕提供稳定驱动。DC-DC芯片提供高效低波纹稳压方案，满足多电压域供电。其他电源管理芯片面向移动与穿戴设备，集成多重保护，提升设备与安全可靠性。

（2）汽车电子芯片

公司汽车电子芯片包括车载电源管理芯片和车载智能驱动芯片，具体情况如下：

产品类别	产品介绍
车载电源管理芯片	芯片为车上的用电器件提供合适的电源电压，将原始的车载电源电压，或者前级的电源芯片输出转换为后级用电器所需要的电压，并提供相应的保护功能。产品包括DC-DC芯片，线性电压芯片，车载充电芯片和专用电源管理芯片，广泛应用于智能底舱、车载充电模块、智能驾驶和车身控制器中。
车载智能驱动芯片	用于车身控制器或者智能配电单元内，可以控制后级负载通断的半导体开关，根据负载和功能的不同，有高边开关、低边开关、半桥驱动、全桥驱动、电子保险丝等不同芯片种类。与传统的继电器和保险丝相比，半导体驱动芯片可以提供更好的负载控制，更安全可靠的实现断电操作，并且在体积和成本上都得到优化。

（3）工业领域芯片

公司工业领域芯片包括高压DC-DC芯片及其他工业电源管理芯片，具体情况如下：

产品类别	产品介绍
高压DC-DC芯片	针对通讯、储能、BMS、电动工具、机器人等工业应用场景的高电压高性能DC-DC产品。产品涉及降压、升压、升降压拓扑架构，最大工作电压60~200V。产品具有超低功耗、高效率、低温升、故障保护功能等。
其他工业电源管理芯片	其他工业电源管理芯片覆盖工业设备、储能系统、安防、机器人等应用，提供供电、电能转换、控制、交互与电路保护等功能。

（4）智能算力领域电源管理芯片

公司智能算力领域电源管理芯片包括多相电源管理芯片及交直流转换电源管理芯片，具体情况如下：

产品类别	产品介绍
多相电源管理芯片	面向算力芯片供电的多相多路大电流输出电源管理芯片，具备高精度调压与多相均流功能，为高性能处理器提供专用供电控制，可广泛应用于自动驾驶、服务器、AI边缘计算等领域。
交直流转换电源管理芯片	覆盖数据中心、新能源、高端电子设备等主流领域。功率因数校正和谐振变换器两级拓扑为硬件根基。

2.2 主要经营模式

报告期内，公司经营模式无重大变化。公司采用的经营模式为行业同行的Fabless模式，主要专注于芯片的设计与销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节外包给第三方晶圆制造和封装测试企业完成。

1、研发模式

公司采用Fabless的经营模式，产品设计及研发是公司业务的核心。公司高度重视研发创新体制的建设与管理，长期致力于建立规范化的产品研发流程及质量控制体系，确保各产品系列在研发的各个阶段均能够实现优质的产品设计、有效的质量保障及可靠的风险管理。公司具体研发流程包括立项阶段、项目设计阶段、产品验证及量产阶段等业务流程，确保产品的研发和验证过程都得以有效的控制和管理。

2、采购及生产模式

公司专注于芯片的研发和销售，通过委托晶圆厂和封测厂外协加工完成晶圆制造和封装测试，公司自身仅从事部分芯片的测试工作。该模式具有技术驱动，灵活高效等特点。在Fabless模式中，公司主要进行芯片产品的研发、销售与质量管控，产品的生产则采用委外加工的模式完成，即公司将自主研发设计的集成电路数据交由晶圆厂进行晶圆制造，随后将制造完成的晶圆交由封测厂进行封装和测试。目前，公司采购的内容主要为晶圆和其相关的封装及测试服务，公司的晶圆代工厂商和封装测试服务供应商主要为行业知名企业。

3、销售模式

公司目前采用“经销为主，直销为辅”的销售模式，即公司既通过经销商销售产品，又向终端厂商直接销售产品。直销模式是指公司直接将产品销售给终端客户，经销模式是指公司将产品买断性地销售给经销商。

2.3 所处行业情况

(1)、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1）所属行业

公司主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售，所处行业属于集成电路设计行业。根据《中华人民共和国国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。公司所处的集成电路设计行业属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》所规定的鼓励类产业，政府主管部门为工信部，行业自律性组织为中国半导体行业协会。

2）行业发展概况

（1）集成电路行业

半导体行业主要以集成电路为主，其他还包括光电子器件、传感器、分立器件。经过60多年的发展，集成电路产业已成为国民经济中的基础性、战略性产业。公司所属的集成电路行业，主要分为微处理器、模拟芯片、逻辑芯片、存储芯片。随着全球“智能化”大潮来袭，各种智能终端设备、汽车、工业控制设备等需求增长带动了集成电路市场规模的不断扩张。同时，伴随着人工智能、大数据、自动驾驶、工业自动化、机器人等创新型产业的快速发展，集成电路产品的应用领域不断拓宽。

2025年，创新的架构和数据处理方式推动大模型进入下一阶段，数据处理范式优势逐渐凸显，将持续推动算力、存力的布局，下游应用如AI PC、AI手机、Robotaxi、机器人等新兴应用场景广阔，AI agent的诞生进一步推进AI应用在各行各业落地的尝试。受AI和存储强劲市场需求拉动，根据世界集成电路协会(WICA)的数据，预计2025年全球半导体市场规模达7,838亿美元，同比增长达23.4%。2026年，预计全球半导体市场规模将突破9,000亿美元，同比增长15.8%。长期来看，全球及中国集成电路产业仍将持续增长。

我国作为全球最大的集成电路需求市场，对高端芯片的进口依赖依然突出，芯片进口金额远超出口金额，凸显出巨大的国产替代空间。集成电路已被国家明确列为六大新兴支柱产业之首，推动高端芯片实现自主可控，加快进口替代进程，已成为我国构建现代化产业体系、实现科技自立自强的关键命题。国家统计局公布的数据显示，2025年中国的集成电路产量为4,842.8亿块，同比增长10.9%。根据海关总署数据，2025年，我国集成电路进口数量总额5,916.9亿块，同比上升7.8%；出口数量总额3,494.7亿块，同比17.4%；贸易逆差2,422.2亿块。

根据中国半导体行业协会的数据，2025年中国集成电路市场规模约为2万亿元，占全球市场份额的41%，为全球最大的单一芯片市场。在人工智能、智能制造、智能算力等需求快速的背景下，国内集成电路增速预计未来依然会高于全球增速。未来，虽然集成电路行业发展会有周期性的波动，但我国集成电路产业的总体趋势依然是不断发展，国产化进程仍在持续推进，我国集成电路产业的市场前景广阔。

（2）模拟芯片行业

模拟芯片主要分为电源管理芯片、信号链芯片两大类，其呈现产品的生命周期较长、下游应用领域广泛且分散，是整个市场发展的晴雨表。得益于行业本身的技术积累和消费电子、汽车电子、工业控制等下游应用领域的发展，模拟芯片行业保持稳定发展。

根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)12月发布的秋季预测报告，2025年全球模拟芯片市场规模预计将实现7%的增长。长期来看，在人工智能、高性能计算、新能源汽车及工业自动化等新兴领域的强力驱动下，模拟芯片市场规模正步入新一轮成长期。根据中商产业研究院发布的《2025-2030年中国模拟芯片行业市场调研及发展趋势预测报告》数据，预计2025年中国模拟芯片市场规模将增长至3,431亿元，同比增速为5.6%。受益于新能源汽车、5G通信、物联网等下游市场的发展以及电子设备数量及种类持续增长，中国模拟芯片市场需求不断增加，国产模拟芯片企业快速崛起，逐步打破国外垄断，设计和制造环节的竞争力逐渐增强，市场份额不断扩大。

3）主要下游应用市场

（1）消费电子行业

公司的芯片产品在消费电子领域有广泛应用，包括智能手机、智能穿戴、笔记本/平板电脑、AR/VR等产品。根据IDC数据统计，2025全年，全球智能手机出货量达到12.6亿部，同比增长1.9%，是继2024年智能手机市场回暖后的进一步复苏。2025年，AI在智能手机的应用进展明显，从简单的功能叠加升级为系统级AI智能体，从端侧大模型、跨App自主执行、多模态交互五全面落地，苹果、三星、小米、OPPO、vivo等多品牌厂商竞相角逐，AI手机这一发展趋势推动智能手机对运算类、存储类、电源管理类等芯片需求和规格演进，对应的芯片市场发展具备成长潜力。

随着消费电子产品的快速更新换代，从传统的电脑、智能手机到新兴的智能穿戴设备如智能手表、耳机、智能眼镜、智能音箱等，这些多样化的产品已成为人们日常生活和工作中不可或缺的工具。这些新兴智能设备终端成为消费电子领域模拟芯片市场的又一增长驱动力。

（2）汽车电子行业

中国是全球最大的汽车和新能源汽车产销国，近年来，我国汽车电子行业稳步发展，产业能力不断提升。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2024年中国汽车电子市场规模约为1.22万亿元，较上年增长10.95%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国汽车电子市场规模将达到1.28万亿元。这一增长得益于新能源汽车的快速渗透和智能化功能的加速普及。

电动化趋势推动汽车电子芯片市场需求增长。根据中国汽车工业协会的统计数据，2025年中国汽车总销量为3,440万辆，同比增长9.4%，其中新能源汽车销量达1,649万辆，新能源汽车渗透率达47.9%，同比增长7%。新能源汽车渗透率的提升将拉动汽车电子芯片市场的增长。新能源汽车的电系统即电机、电控和电池管理系统对功率半导体的需求显著高于传统燃油车，同时，电动车对芯片的数量和复杂度要求也明显高于传统燃油车，1.3级以上的智能汽车芯片需求甚至突破3,000颗/辆，约为传统燃油车的5倍。

智能化趋势重塑汽车芯片的技术格局。高算力与异构集成被广泛需求，以满足多传感器融合和实时决策。智能汽车搭载的传感器数量显著增加，摄像头和激光雷达需求普及，5G-V2X和车载以太网通信推动通信芯片需求增加。智能座舱从单一娱乐功能转向多屏交互、语音助手和AR HUD融合，未来的汽车将不仅仅是一种交通工具，更将成为一个集休闲、办公、娱乐于一体的“移动智能空间”。

汽车电动化和智能化为国内汽车半导体产业的发展提供了新的动能。在全球供应链重组和国际贸易环境变化的背景下，提升国内汽车半导体的自主研发和生产能力，不仅能够降低对外部供应链的依赖，也有助于推动国内半导体产业的整体技术水平和竞争力。

（3）工业应用

在工业领域，模拟芯片扮演着至关重要的角色，它们是实现信号处理、数据转换和电源管理等功能的核心组件。随着工业4.0的推进和智能制造的兴起，模拟芯片在提高系统性能、增强能效和优化成本效益方面展现出巨大的潜力。2025年工业领域的模拟芯片市场呈现库存修复，需求高增长的特征。根据新浪财经的数据显示，2025年中国工业模拟芯片市场约600亿元，年增速保持在12%-15%。

在工业4.0推进下，PLC、传感器等设备升级，带动高精度模拟芯片需求激增；光伏、储能、风电等新能源领域的爆发和电网的建设，也驱动功率模拟、电流传感器等模拟芯片需求高速增长。AI和具身智能的演进，进一步打开电源管理芯片、功率芯片、信号处理芯片、传感芯片等模拟芯片需求空间。随着全球供应链的重组和国产化替代的推进，本土模拟芯片制造商有机会通过技术创新和产品差异化来抓住市场机遇。

4）主要技术门槛

集成电路设计行业是典型的技术密集、知识密集和资本密集型行业，拥有较高的行业准入壁垒。

公司产品覆盖消费电子芯片、汽车电子芯片、工业领域芯片，智能算力领域电源管理芯片等，为客户提供电池管理、电源管理，智能驱动等系统应用功能，这些产品研发需要模拟电路、数字电路及软件开发的专业技术。国内模拟芯片设计工程师供给严重短缺，加之模拟电路设计经验依赖于大量实际工程项目的积累，因此进入模拟芯片设计领域专业技术壁垒高。

公司自成立至今紧紧围绕客户需求开发产品，为客户提供端到端的解决方案，通过大量的产品开发，不仅积累了模拟电路设计技术，还构建了数字电路设计、软件开发的能力，这构成了公司研发高性能、集成度产品的竞争力。截至报告期末，公司累计获得199项授权专利和32项核心技术。

公司产品下游应用包括手机、笔记本电脑等高端消费领域，汽车及工业领域。其中手机内部电源管理芯片因对其体积、稳定性、一致性要求较高，且公司产品主要用于充电管理及电池管理，对安全及性能要求较高，对产品技术迭代的要求较高；汽车领域和工业应用场景对芯片的安全性和可靠性、产品质量有更高的要求，技术门槛要求更高。

综上，公司所处行业存在较高的行业壁垒。

（2）公司所处的行业地位分析及其变化情况

南芯科技是国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一，公司具备较强的产品研发能力，产品应用领域已覆盖消费电子、汽车电子及工业领域，产品品类以充电管理、DC-DC等为起点已逐步扩充至AC-DC、电池管理、驱动芯片、车规级电源管理芯片及符合工业标准的电源管理芯片等。公司的市场地位主要体现在以下方面：

（1）国内领先的规模与增长标杆

南芯科技已成长为中国境内规模位居行业前列、且增长速率显著高于行业平均水平的模拟芯片设计企业。2025年，公司实现营业收入32.61亿元，归属于母公司所有者的净利润2.39亿元；2019年至2025年，公司营业收入复合增长率为76.60%。凭借在产品端的快速放量与在高端市场的持续突破，公司业务规模迅速扩张，已成为国内模拟芯片产业中兼具领先地位与高成长性的核心企业。

（2）细分市场奠定领导地位

在移动终端电源管理领域，公司已构筑起覆盖从适配器AC输入到手机内部电池供电完整链路的系统性产品矩阵，包括AC-DC、充电管理、有线充电、无线充电及电池管理等多个核心环节，形成了全链路、多层次的综合解决方案能力。凭借这一完整布局，公司在手机终端电源管理芯片上已实现市场占有率的大幅领先，深度导入小米、OPPO、vivo、荣耀、三星等主流手机品牌的全系列产品线，尤其在旗舰及畅销机型中已成为核心电源管理方案的主要供应商，出货量与销售额均居行业领导地位。同时，通过将移动电源管理领域积累的技术优势与平台化能力向车载充电场景延伸，公司已成为车载充电、智能驾驶等域的国内领先者。

（3）AI产业链全面布局，多维驱动的平台型模拟芯片公司

公司深刻洞察“云端协同、云边端一体”的算力发展趋势，已进行系统性前瞻布局，成为覆盖“云、网、边、端”AI全场景的模拟芯片解决方案提供商。在“云”侧，公司直面高算力芯片的供电挑战，通过研发多相控制器，推出工业级LLC SR控制器等产品，应用于AI服务器与数据中心电源管理这一高技术壁垒市场。在“边”与“网”侧，公司将高性能电源技术适配于工业电脑、光伏储能、通信设备等多元化边缘计算与网络基础设施。在“端”侧，公司的产品不仅广泛应用于AI手机、AI PC、AI眼镜等下一代智能终端，还通过提供多品类车规级芯片及深度赋能智能驾驶，凭借平台化的技术复用与创新能力，公司已逐步构建起AI全产业链产品矩阵，能够全方位把握人工智能浪潮带来的市场机遇。

（4）卓越的品牌声誉与客户认可

公司的产品与技术已获得下游多家全球知名终端品牌厂商的高度认可，并与之建立了长期、稳定的战略合作关系。这不仅体现在消费电子领域的头部手机与笔电品牌，也涵盖了在电源配件行业领先的品牌以及新兴的汽车电子客户。这种深度的客户合作关系，是公司品牌价值、技术实力和量产保障能力的综合体现。为持续经营与市场拓展奠定了坚实基础。

（3）、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）第三代半导体材料GaN应用趋势更明显

凭借开关速度快、功率密度高、高频等特点，GaN在消费电子快充领域得到充分应用，集成GaN的电源适配器体积小，携带方便，输出功率高，实现充电效率高，在高端机型日益广泛应用。在2024年头部企业加速整合GaN技术后叠加新兴应用场景的牵引，2025年GaN技术的发展和应用获得进一步的突破。技术层面，8英寸硅基GaN晶圆量产良率突破85%，英飞凌推进的300mm GaN功率晶圆技术使单片晶圆芯片数量获得提升，显著降低器件成本，推动GaN逐步进入与传统硅基器件的性价比竞争区间。应用层面，消费电子应用规模化进入成熟阶段，新兴场景的应用也逐步获得技术验证和商业落地。GaN快充方案已成为苹果、三星、小米等头部品牌旗舰产品的标配，低压硅基GaN射频功率放大器实现技术突破，为6G时代终端射频架构奠定基础。在AI数据中心，800V HVDC供电架构加速落地，650V和1200V GaN器件凭借高频、高效优势，成为DC-DC电源模块的核心选择，预计在短期的未来商业化落地会加速。在新能源汽车领域，GaN技术从车载OBC（车载充电器）向主驱逆变器延伸，英诺赛科实现GaN器件装车应用，长安、宝马等整车厂加速推进配套验证。在通信与工业领域，GaN射频功放已批量应用于5G基站，同时GaN在光伏逆变器、微型储能等工业场景的量产交付规模持续扩大。2025是GaN技术迈入规模化商用与高端化渗透并行的关键发展阶段，技术成熟度与应用广度均实现跨越式突破，成为驱动相关行业应用的核心动力。

（2）电动化、智能化和网联化驱动汽车电子芯片快速发展

随着全球汽车产业向电动化、智能化、网联化加速转型，智能座舱、ADAS（高级驾驶辅助系统）等核心领域对车载芯片的性能、集成度及环境适应性提出了严苛要求。

车身系统主要负责车身各种功能的控制。目前，为降低成本和车身重量，传统的分布式架构（每个功能对应一个ECU）正被域控制器架构取代。车身域控制器从分散化的功能部署，逐渐过渡到集成所有车身电子的基础驱动、钥匙/功能、车灯、车门、车窗等的大型控制器，车身域控制系统设计综合了灯光、雨刮洗涤、中控门锁、车窗等控制，PEPS智能钥匙、电源管理等，以及网关CAN、可扩展CANFD和FLEXRAY、LIN网络，以太网等接口和模块等多方面的开发设计技术。这种转变对车身MCU提出了更高要求，需要其具备更强的算力、更丰富的通信接口（如CAN/CAN-FD、LIN）以及更高的集成度，从而直接拉动了此类芯片的价值和需求。

随着汽车智能化的发展，座舱集成化程度越来越高，原先分散的ECU逐渐整合为一个座舱域控制器，这种集成化变革最直观的表现是“一芯多屏”，即由座舱域控制器中的单个高性能SoC芯片来驱动座舱内多个屏幕。此外，随着汽车向智能化迈进，智能座舱的交互方式变得更加智能化和多样化，从传统的物理按键触觉交互，升级为语音交互、手势控制以及视觉交互(DMS/OMS)等多模态交互方式。因此，未来对于更高算力、更大带宽、更高速传输的智能座舱芯片需求日益高涨。

智能驾驶芯片发展主要有三大趋势，共同推动智驾芯片进入新